



2025年11月13日

各 位

会 社 名 株式会社デジタルメディアプロフェッショナル
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長CEO 山本 達夫
(コード番号3652、東証グロース)
問 合 せ 先 代表取締役専務 経営企画部長 大澤 剛
T E L 03-6454-0450

2026年3月期第2四半期決算説明会書き起こしのお知らせ

2025年11月12日に開催しました「2026年3月期第2四半期決算説明会」の書き起こしを公開しましたので、お知らせします。2026年3月期第2四半期決算概要、2026年3月期通期業績予想、成長戦略・ビジョン等についてご説明していますので、ご参照ください。

【2026年3月期第2四半期 決算説明会概要】

日時：2025年11月12日 16:30～17:20

説明者：代表取締役会長兼社長CEO 山本 達夫

代表取締役専務 経営企画部長 大澤 剛

MAKING THE IMAGE INTELLIGENT



2026年3月期 第2四半期 決算説明会

株式会社デジタルメディアプロフェッショナル
2025年11月12日

本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。
様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

専務の大澤でございます。

本日は株式会社デジタルメディアプロフェッショナルの2026年3月期第2四半期決算説明会にご参加いただき、ありがとうございます。

1 2026年3月期 第2四半期 決算説明

2 2026年3月期 通期業績予想

3 成長戦略・ビジョン

本日のアジェンダですが、2026年3月期第2四半期決算と2026年3月期通期業績予想について私からご説明し、その後、成長戦略・ビジョンについて、山本が説明いたします。

1 2026年3月期 第2四半期 決算説明

2 2026年3月期 通期業績予想

3 成長戦略・ビジョン

世界有数のグラフィックスIPベンダーとしての創業以来の経験・知見を活かし、近年は**アルゴリズム・ソフトウェアからハードウェア**、並びに**エッジからクラウド**に亘る一貫したAIサービスの提供により、お客様や社会の課題解決に貢献しています

会社名	株式会社デジタルメディアプロフェッショナル (DMP)	IPコアライセンス事業 <ul style="list-style-type: none"> AI/GPU IPコアライセンス AIソフトウェアライセンス 
設立	2002年7月 (2011年6月東証マザーズ上場, 2022年4月東証グロース移行)	
所在地	東京都中野区	製品事業 <ul style="list-style-type: none"> アミューズメント市場向け画像処理半導体 エッジAI半導体 協働ロボット向けビジョンシステム FA製品 (AMR本体/コンポーネント) モジュール 
代表者	代表取締役会長兼社長CEO 山本 達夫	
資本金	1,838百万円	プロフェッショナルサービス事業 <ul style="list-style-type: none"> AIアルゴリズム、コンピュータビジョンソフトウェア受託開発 FPGA/ボード受託開発 ロボティクス・セーフティに係る顧客製品・サービス開発サポート 
連結従業員数	60名 (2025年4月1日現在)	
特許数	35件	

まず、2026年3月期第2四半期の決算の前に、当社の概要について簡単にご説明します。

当社は、2002年7月に大学発のベンチャー企業として発足以来、グラフィックス技術を核にして事業を行い、GPU IP が任天堂のゲーム機に採用されたり、アミューズメント市場向けに2D/3D 統合グラフィックスLSIを投入し現在の収益の柱にするなどの大きな成果を上げてきました。

近年は、GPUと親和性の高いAI/Deep Learning 領域に進出し、アルゴリズム・ソフトウェアからハードウェア、並びにエッジからクラウドに亘る一貫した開発体制、製品・サービスを提供できることを強みとして、DMPならではの技術、製品、サービスで、お客さまや社会のシリアスな課題の解決とAIの社会実装に貢献しています。

昨年度開発に着手した次世代エッジAI半導体「Di1」は現在精力的に拡販活動を行っており、今年度第4四半期に量産開始予定です。

- 中期的な2本の成長エンジンの収益化基盤構築に向け、戦略的投資・リソース傾注
- エッジAI半導体「Di1」の開発・拡販、FA事業（AMR本体・コンポーネント販売実績）は順調
- パチスロの保通協の検定試験適合率が低調に推移していることにより、アミューズメント市場が一時的に停滞し、「RS1」の量産出荷も弱含みで推移。下期にかけて有力機種投入により、回復見込
- 「半導体」技術を基軸とした経営資源集中という戦略的判断のもと、ベトナム拠点の事業を終了

全社	事業別売上高	分野別売上高
売上高	IPコアライセンス	ロボティクス・セーフティ
902 百万円 (YoY* △41%)	55 百万円 (YoY +14%)	118 百万円 (YoY +42%)
経常利益	製品	アミューズメント
△292 百万円 (前年同期 143百万円)	827 百万円 (YoY △42%)	740 百万円 (YoY △48%)
	プロフェッショナルサービス	その他
	19 百万円 (YoY △65%)	43 百万円 (YoY +41%)

※ YoY (Year on Year) : 前年同期比

それでは、2026年3月期第2四半期のハイライトからお話します。

中間期の業績は、売上高9億2百万円、経常損失2億92百万円と減収減益となりました。アミューズメント市場の一時的停滞が減収の主要因ですが、減益の要因の一つである次世代エッジAI半導体「Di1」の開発投資は当社が未来への「攻めの戦略的投資フェーズ」に入っていることを反映したものです。これは、中長期的な企業価値向上、将来の収益基盤強化のための積極的な布石です。

現在、アミューズメント市場では保通協の検定試験適合率が一時的に低調に推移し、主力製品「RS1」の出荷が減少していますが、これは一過性のもものと捉えています。下期にはサミー様など遊技機メーカーの有力新機種の出荷が控えており、「RS1」の量産出荷の回復を見込んでいます。

成長分野であるロボティクス・セーフティ分野の売上は、新たに開始したFA事業の貢献もあり、前年同期比42%増の1億18百万円と拡大しています。また、IPコアライセンス事業も14%増と堅調に推移しています。

また、半導体技術を基軸とした成長領域への経営資源集中を進めるため、今年9月末をもって主にソフトウェア開発を行っていたDMPベトナムの事業を終了しました。これは、当社の中核技術である半導体技術にさらにフォーカスし、限られた経営資源を最も成長性の高い領域に集中投下するための戦略的判断です。

アミューズメント市場の一時的停滞と戦略的半導体開発投資により減収減益

(単位：百万円)	2025年3月期 中間期	2026年3月期 中間期	増減額
売上高	1,535	902	△632
営業利益	144	△299	△444
経常利益	143	△292	△435
親会社株主に帰属 する中間純利益	121	△313	△435

- 戦略的投資として、次世代エッジAI半導体「Di1」の開発費143百万円を支出
- 保通協の検定試験適合率の低調推移に伴うアミューズメント市場の一時的停滞により、画像処理半導体「RS1」の出荷は前年同期と比較してほぼ半減。売上高は41.2%減収
- 前年同期比減収と「Di1」の開発費計上により、営業利益、経常利益は前年同期比減益
- 特別損失として投資有価証券評価損19百万円を計上したことにより親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比減益

続いて、PLの概要です。

主にアミューズメント市場の一時的停滞に伴うRS1出荷減により、売上高は9億2百万円、41.2%の減収となりました。

前年同期比減収と戦略的投資として次世代エッジAI半導体「Di1」の開発費143百万円を支出したことにより、営業損失は2億99百万円、経常損失は2億92百万円、特別損失として投資有価証券評価損19百万円を計上したことにより、親会社株主に帰属する中間純損失は3億13百万円となりました。

2026年3月期 第2四半期決算ハイライト - 事業／分野別売上高

● 事業別売上高

IPコアライセンス事業 55百万円 前年同期 48百万円

- デジタル機器向けAI/GPUランニングロイヤリティ、ロボティクス・セーフティ分野におけるリカーリング収益、メンテナンス・サポート収入等を計上

製品事業 827百万円 前年同期 1,431百万円

- RS1の量産出荷、Cambrianビジョンシステム、ドローン向けカメラモジュール、FA製品等の売上を計上
- アミューズメント市場の一時的停滞により、RS1の量産出荷は前年同期比半減。下期にかけて回復を見込む

プロフェッショナルサービス事業 19百万円 前年同期 55百万円

- 半導体製造設備、AMR向け受託開発サービス収入等を計上

● 分野別売上高

ロボティクス・セーフティ分野* 118百万円 前年同期 83百万円

- ドライブレコーダー関連のリカーリング収益（ランニングロイヤリティ、サブスクリプションフィー）、メンテナンスサポート収入、Cambrianビジョンシステム、ドローン向けカメラモジュール、FA製品等の製品売上、並びに半導体製造設備、AMR向けプロフェッショナルサービス売上を計上

アミューズメント分野 740百万円 前年同期1,420百万円

- 主にRS1の量産出荷売上を計上

その他分野 43百万円 前年同期 30百万円

- デジタル機器向けAI/GPUランニングロイヤリティ、メンテナンスサポート収入等を計上

※ 当分野は、2025年3月期までは「セーフティ分野」、「ロボティクス分野」に分けていたが、協働ロボットやAMRを例に見てもロボティクス技術の進化と社会実装が進むほど、人・モノとの接触やそのリスクを検知するセーフティ技術が重要となっていることに加え、当社の事業方向性も踏まえ、2026年3月期より両分野を統合し、「ロボティクス・セーフティ分野」と呼称することとした

続いて事業別／分野別の売上高です。

製品事業とアミューズメント分野は、保通協の検定試験適合率が低調に推移した影響で、画像処理半導

体 RS1 の量産出荷が前年同期比で半減したことにより減収となりましたが、下期にかけて遊技機メーカーの有力新機種投入が控えており回復を見込んでいます。

ロボティクス・セーフティ分野では、自律走行ロボット（AMR）や協働ロボットに関わる技術・社会実装の進展を追い風に、Cambrian ビジョンシステム、ドローン向けカメラモジュール、中国先進企業の AMR 本体やコンポーネントを扱う FA 事業、半導体製造設備や AMR 向けプロフェッショナルサービスなど、すそ野の広い収益を計上し、増収となりました。なお、当社は 2026 年 3 月期より、セーフティとロボティクスを統合してロボティクス・セーフティ分野と定義し、成長領域への集中度を高めています。

また、IP コアライセンス事業、その他分野も堅調に増収となりました。

プロフェッショナル事業の減益は、安全運転支援向けのプロフェッショナルサービス収益が乏しいことが主要因ですが、LLM（大規模言語モデル）を活用した案件が進捗中であり、また後ほど山本より説明予定の Vision-LLM Insight に関連したより広範なセーフティ分野向けサービスも今後増加すると考えています。

2026年3月期 第2四半期決算ハイライト - 貸借対照表



自己資本比率は87.7%と高水準を維持

～戦略的投資を可能にする強固な財務体質～

(単位：百万円)	2025年 3月末	2025年 9月末	増減額	主な増減要因
流動資産	3,297	2,761	△536	現金及び預金 △486 有価証券 △200 棚卸資産 +142
固定資産	794	996	+202	投資有価証券 +182
資産合計	4,092	3,758	△334	
流動負債	461	441	△20	買掛金 +63 その他 △74
固定負債	19	18	△0	
負債合計	480	460	△20	
純資産合計	3,611	3,297	△313	利益剰余金 △313
負債・純資産合計	4,092	3,758	△334	

続いて BS です。

資産合計は 37 億 58 百万円、前年度末から 3 億 34 百万円減少しました。これは主に現預金が 4 億 86 百万円減少、有価証券が 2 億円減少、たな卸資産が 1 億 42 百万円増加、投資有価証券が 1 億 82 百万円増加したことによるものです。

負債合計は 4 億 60 百万円、前年度末から 20 百万円減少しました。これは主に買掛金が 63 百万円増加、未払金を中心としたその他流動負債が 74 百万円減少したことによるものです。

純資産は 32 億 97 百万円、前年度末から 3 億 13 百万円減少しました。これは主に親会社株主に帰属する中間純損失の計上により、利益剰余金が 3 億 13 百万円減少したことによるものです。

この結果、自己資本比率は 87.7%となりました。引き続き、成長投資と機動的支出を可能にする強固な財務基盤を維持しております。

1 2026年3月期 第2四半期 決算説明

2 2026年3月期 通期業績予想

3 成長戦略・ビジョン

2026年3月期 通期業績予想

5月13日公表の通期業績予想に変更なし

～2026年3月期は将来の成長に向けた攻めの戦略的投資を実行～

(単位: 百万円)	2025年3月期 通期実績	2026年3月期	
		通期予想	増減率
売上高	3,077	3,250	+5.6%
営業利益	265	20	△92.5%
経常利益	271	25	△90.8%
親会社株主に帰属 する当期純利益	157	20	△87.3%

- 中間期は、特にパチスロの保通協等による検定試験の適合率が低調に推移していることにより「RS1」の量産出荷も一時的に弱含みも、遊技機メーカーの有力な新機種の出荷が控えていることから、下期にかけて量産出荷の回復を見込む
- 第3四半期に「Di1」の戦略的開発投資の残りUS\$100万ドルを計上見込
- 中期的には、アミューズメント市場の更なる取り込みに加え、エッジAI半導体事業とFA事業の2本の成長エンジンにより、収益拡大、企業価値向上を目指す

最後に、進行期の2026年3月期の通期連結業績予想ですが、5月13日に公表した予想に変更はありません。売上高は32億5千万円、5.6%の増収、利益面では戦略的投資を継続するため、営業利益は20百万円を予想していますが、これは将来の収益拡大のための必要な投資と考えています。

下期にはアミューズメント市場の回復に加え、Di1への開発投資も最終局面を迎え、来年度以降の収益貢献に向けた確かな土台が築かれます。

中期的には、安定したアミューズメント事業を基盤としながら、エッジAI半導体事業とFA事業の2本の成長エンジンにより、飛躍的な成長を目指します。特にエッジAIチップ市場は2030年までに年率30%以上の成長が見込まれており、当社のポジショニングはこの成長市場を捉える絶好の位置にあります。

当社は現在、長年培ってきた半導体技術に基づく成長戦略と強固な財務基盤を背景に、将来の飛躍に

に向けた準備を着々と進めています。短期的な業績変動の裏側にある中長期的な成長ストーリーにご注目いただければ幸いです。

以上を持ちまして、私のパートを終わります。ご清聴ありがとうございました。



1 2026年3月期 第2四半期 決算説明

2 2026年3月期 通期業績予想

3 成長戦略・ビジョン

DMPのPurpose

Making the Image Intelligent

画像を智能化する

画像インテリジェンスの力で現実世界の問題を解決し、ステークホルダーに価値をもたらす革新的な製品とサービスを創造する

To develop cutting-edge products and services that leverage image intelligence to address practical challenges and deliver value to our stakeholders.

MAKING THE IMAGE INTELLIGENT Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved. 12

続いて、私、山本から成長戦略・ビジョンについてお話します。当社のパーパスは、「Making the Image Intelligent」です。主に AI 技術を使って画像を智能化することです。画像インテリジェンスによって現実世界のさまざまな社会課題を解決し、ステークホルダーの皆さまに価値をもたらす革新的な製品とサービスを創造しています。

生成AIの進化と拡張(2025年)



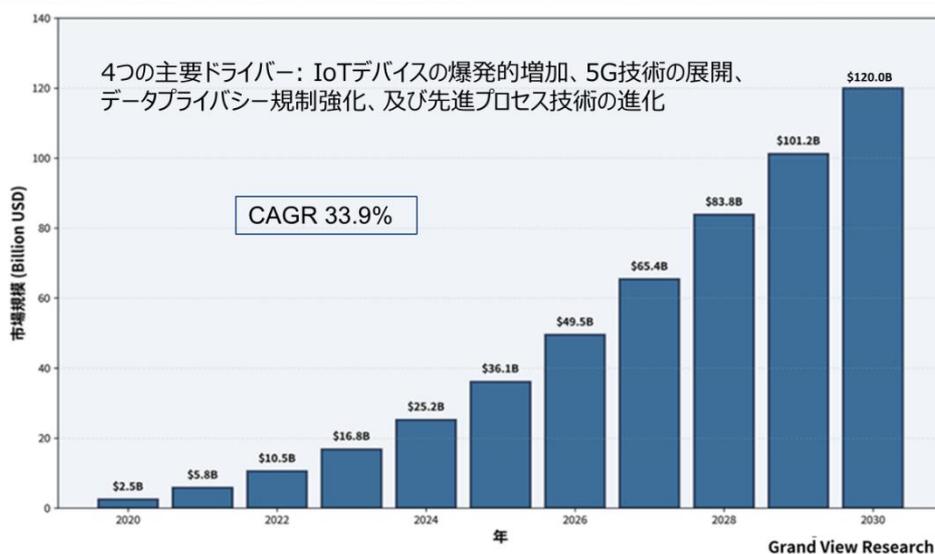
我々を取り巻く環境についてお話します。AIの世界は非常に速いスピードで動いており、3カ月、半年で状況が変わっていきます。その中で当社に関係のあるキーワードをいくつか拾いました。左から、まず「マルチモーダル」とありますが、これはAIがテキストだけではなく、画像や音声、複数のデータを理解し、生成することができるようになったということで、特にChatGPTの出現以来、ここ3年ぐらいでこの世界は大きく広がりました。それから「エージェントAI」です。これはAIが自律的に行動や意思決定を行うもので、例えば、営業の顧客データを解析してスコアリングし、潜在的な見込みのあるお客さまにアプローチ、売り込みをかける、レストランの予約をする、あるいは旅行のアレンジをする、そのようなことをAIがやるというもので、おそらく、ここ1年ぐらいで急速にこの分野は進化してきています。次に、「フィジカルAI」とありますが、これは非常に重要なキーワードで、AIが自ら自律的にロボットを操作し、様々な複雑な作業をこなしていくといった技術です。このフィジカルAIという言葉が明確に出てきたのは、私の記憶では、今年1月のCESのNVIDIA CEO ジェンスン・フアン keynoteスピーチです。最近ソフトバンクの孫正義氏もこれに呼応し、これからフィジカルAIの時代だと声を大にしておっしゃっています。例えば、最近ソフトバンクがスイスの大手のロボットメーカーABBを買収していますが、これもフィジカルAIの流れに沿った動きです。当社は実は2021年にCambrianというイギリスの会社に投資をしていますが、同社はまさにフィジカルAIのシステムを開発しており、AIとデジタルツインというシミュレーション技術にゲームエンジンを融合させ、ロボットにカメラを付けることによって、非常に複雑な作業をこなすことができます。例えば、透明な物を掴んだり、あるいはケーブルのハンドリング等、従来、ロボットができなかったようなことができるようになってきています。したがって、この分野は当社が既に数年にわたって取り組んでいるものです。さらに、一番右側に「エッジAIとハイブリッドコンピューティング」とありますが、これは最近の動向で、かつ、非常にホットな分野です。次のページでさらに説明しますが、エッジAIは、従来クラウドで学習をしてエッジで推論することが基本的な形だったのですが、エッジサイドで学習も同時に行ってしまうという動きです。これによって、現場のタスクに応じてAIの学習モデルをチューニングしたり、再学習することによって、より高度な推論が行われるようになります。これに関し、本日、当社がNVIDIA製品を今後販売していくことを発表しています。後ほど少し詳しく説明します。

マルチモーダルによりエッジAI市場が爆発的に拡大



今お話したことを図にしたものが、このスライドです。左側にクラウドがあって、そこで学習・推論をやりますが、右側のエッジサイドで推論を主にやっており、この推論が先ほどお話したマルチモーダルという技術、すなわち、ロボットや車が文字だけでなく、画像や動画、あるいは音声を理解し、いろいろ仕事をするということができるようになってきたことによって、この推論の世界が爆発的に伸びてきたと我々は理解しています。さらに、先ほど申し上げたハイブリッドコンピューティングの技術により、右のエッジ側で学習も行えるようになってきています。それによって、例えばヒューマノイドのロボットが現場に合わせたチューニングを再学習という形で行うことができるようになることで、さらに高度な作業を行えるようになってきます。自動運転もそうですが、このようなことがこのエッジ AI の市場の成長をさらに押し上げていくと考えられています。

エッジAIチップ^o世界市場規模予測



これがエッジ AI チップ市場の今後の市場規模の予想ですが、2030 年まで CAGR 30%以上で伸びてい

くとされています。この大きな要因は、IoT デバイスの爆発的な増加、5G・6G の技術の展開、あるいはエッジ側で AI を行うことによってプライバシーを含めたデータセキュリティを解決するという動きといったものです。今、私がお話したフィジカル AI、あるいはハイブリッドコンピューティングがさらにこの成長を加速させていくと考えられています。

Edge AI Semiconductor Leading Company

DMP DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS

DMP

「エッジAI半導体のリーディングカンパニー」へ

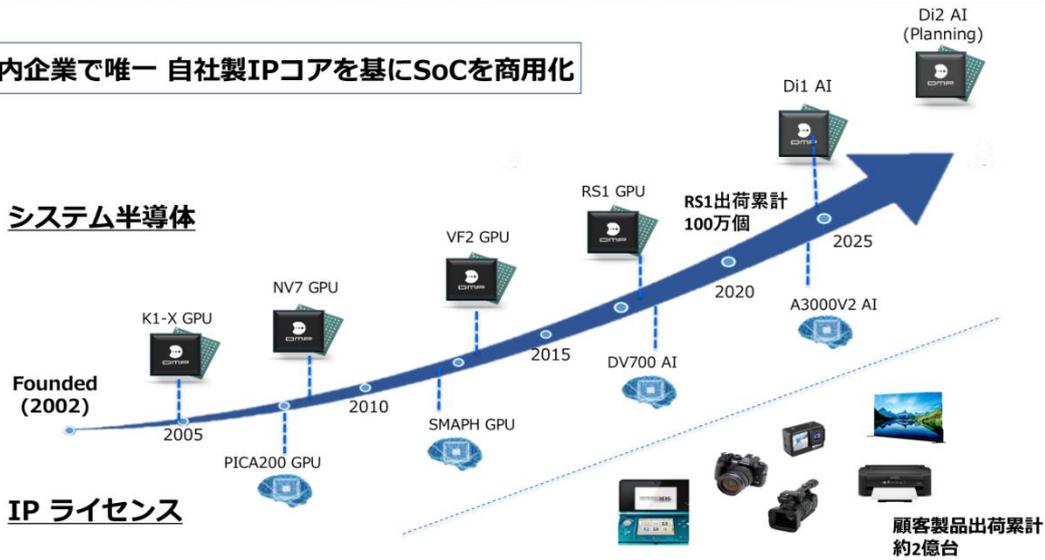
- 20年以上のGPU/AIプロセッサ開発経験
- ドメイン最適化を可能にするアルゴリズム、ソフトウェア、SoC、システムの統合開発プロセス
- GPU/AI IPライセンスによる顧客製品出荷累計約2億台
- アミューズメント向けSoC「RS1」出荷累計100万個突破（2025年12月）

MAKING THE IMAGE INTELLIGENT Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved. 16

DMP は、このエッジ AI 市場のど真ん中にエッジ AI 半導体を投入して、エッジ AI 半導体のリーディングカンパニーを目指してまいります。

これまで 20 年以上の GPU/AI のプロセッサ開発経験、この開発経験から築かれたドメイン最適化を可能にするアルゴリズム、ソフトウェア、SoC、システムの統合開発プロセスに基づいた当社の GPU/AI IP を搭載したお客さまの製品出荷累計台数が約 2 億台に達しています。また、アミューズメント向けの SoC が当社の現在の主力製品ですが、これも出荷累計 100 万個を突破する予定です。このような実績をもとにエッジ AI 半導体の事業において、リーディングカンパニーを目指してまいります。

国内企業で唯一 自社製IPコアを基にSoCを商用化



これは我々の半導体ビジネスを時間軸で見たものです。まず DMP は国内企業で唯一、自社製の IP コアをもとに AI SoC を商用化している会社です。当社はこれまで創業以来、半導体を開発し続けてきており、左から4つめの RS1 が今、アミューズメント業界（パチスロ）でトップシェアになってきており、100 万個の累計出荷を達成しています。そして、今回 Di1 という AI の半導体を開発しており、今後これに続く Di2（仮称）の開発も続けていくといったロードマップになっています。また、この半導体の中核にある当社の GPU IP と AI IP を IP ライセンスビジネスにおいて、半導体あるいは OEM のお客さまにライセンスしてきていますが、これが Nintendo のゲーム機をはじめ、数多くの製品に採用され、今、カウントできる数字としては大体 750 くらいのお客さまの製品に搭載され、その累計出荷台数は 2 億台に達しています。

DMP Di1 エッジAIチップ

DMP Di1 Core Strengths



エッジAI向けに最適化された設計

- 消費電力・性能・コストバランス
- ファンレス、ヒートシンクレス



オープン&セキュアなAIプラットフォーム

- 標準AIフレームワークに対応、高い移植性・拡張性
- セキュアエンジン搭載、機密データを安全に処理
- ブロックチェーン実装によるデータ改ざん防止

日本発・グローバル対応チップ

- DMPの豊富な組み込みAI/GPU技術を結集
- 地政学リスクなしで世界各国展開可能

DMP の Di1 はエッジ AI 向けに、消費電力・性能・コストのバランスを最適化させた設計になっており、その

低消費電力により、例えばファンやヒートシンクがいらぬことで放熱部品を含めたトータルシステムコストを低減することができます。また、オープンセキュアな AI プラットフォームで世界標準の AI フレームワーク ONNX（オニクス）に準拠しております。これによって非常に高い移植性、拡張性を実現しています。また、高度なセキュリティエンジンを搭載することによって機密データを安全に処理することができるほか、ブロックチェーンを実装することで、データの改ざんの防止が可能になります。また、地政学的な観点から見ると、DMP の技術を結集した日本発、日本製のチップということで地政学的リスクなしで世界各国に展開できます。例えば日本のお客さまでも安全保障上の理由で、AI チップは国産のものを使いたいという要望が非常に強いですし、海外、例えばインド市場においても中国との地政学的な問題の中で中国製の部品を別の部品に置き換える、国産化を進めるという動きが加速している中で、日本製は非常に歓迎されている状況になっていると理解しています。そのような意味で非常に売やすく、お客さまから見ても使いやすいチップとなっていると思います。

DMP エッジAIカメラSoC「Di1」ユースケース





オートモーティブ



セキュリティ



AMR/ロボティクス





サイネージ



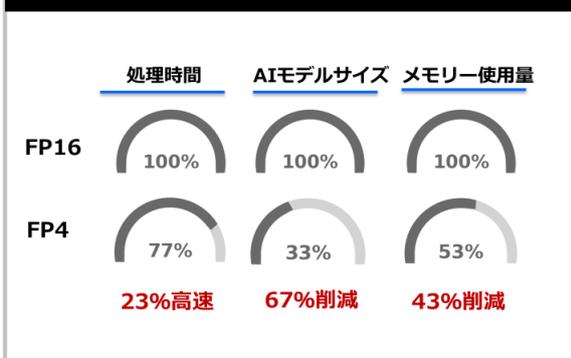
スマートファクトリー



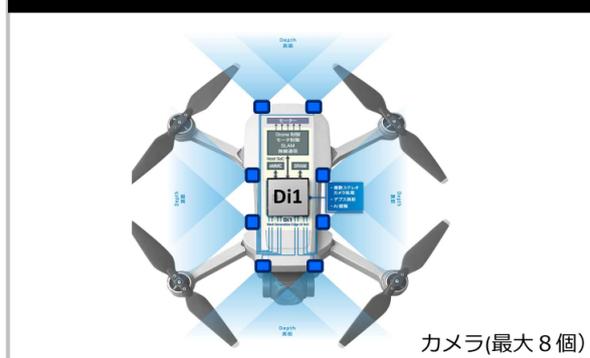
ドローン

MAKING THE IMAGE INTELLIGENT
Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.
19

オートモーティブ、AMR/ロボティクス、スマートファクトリー（FA）、ドローン、サイネージ、店舗、セキュリティ、スマートシティといった市場に Di1 を拡販していきます。

**エッジAIで世界で初めてFP4を搭載
高精度推論とメモリーサイズ大幅低減を両立**


注) FP16: 浮動小数点16ビット演算, FP4: 浮動小数点4ビット演算

**クアドチャンネルステレオビジョン搭載
360度インテリジェンスを実現**


このチップの特徴の一つは、エッジ AI で世界で初めて FP4 という技術を搭載しています。この FP4 は浮動小数点 4 ビット演算という技術なのですが、これを実装することにより、例えば従来の FP16、16 ビットの浮動小数点演算に比べて処理速度が 20%以上高速になり、AI のモデルのサイズが 70%近く削減できます。また、それによってメモリーの使用量も 40%以上削減することによって、非常に軽量の AI モデルで高い精度で非常に処理時間も短く AI が実行できるということが特徴になっています。FP4 は昨年 3 月に NVIDIA が Blackwell という最新の AI のプロセッサに搭載した技術なのですが、それを DMP が世界で初めてこの推論側のチップに実装することにより、この高精度演算および高効率、軽量の AI を高い精度で動かせるようになりました。NVIDIA の FP4・FP16 と非常に親和性が高く、NVIDIA で学習し、DMP の Di1 で推論するということが非常にシームレスにつながっていくことで、まさに Blackwell Ready と言ってもいいような推論チップに仕上がっています。もう一つの特徴として、右側に Quad Channel Stereo Vision (360 度インテリジェンス) とあります。これは Di1 が 8 個のカメラを同時に接続することができ、この 8 つのカメラを 4 つのステレオのペアとして構成することができることにより、4 方向 360 度の障害物検知が可能になります。例えばドローンに搭載した場合、この Di1 を載せるだけで衝突しない極めて信頼性の高いドローンを作ることができるということで、ドローンメーカーさんから非常に高い関心を持っていただいている状況です。

2025年9月から提供開始



評価ボード
カメラモジュール (2025年11月から)
Software & Tools
ドキュメント

Di1 のスターター（開発）キットは、今年 9 月から提供を開始し、これに搭載できるカメラモジュールも DMP 製なのですが、今月から提供を開始しています。

EdgeTech+ AWARD 2025 DMP Di1がEdge Technology優秀賞受賞



Edge Technology 優秀賞

CG-05 デジタルメディアプロフェッショナル
エッジAIカメラSoC Di1

世界初FP4対応、ViTとステレオビジョン技術でAI開発加速

Di1は、これまで高価なSoCでしか実現困難だった高度機能をワンチップに統合したエッジAI向けSoCです。世界初のFP4対応NPUIは、VLM/LLMなど高度AIモデルを電力効率高く低コストでエッジ処理を実行します。一般的なINT8と比べAI処理性能1.9倍向上、メモリ40%削減。独自ステレオビジョンエンジンは他社比22倍の電力性能比で高速3D測距を実現し、放熱部品不要でコスト・重量を大幅削減します。4K HDR ISPやAIとの組み合わせで、ドローン・ロボティクスに求められる3D空間の視覚認識・AI処理を高速低消費電力で実現。豊富なI/Oと堅牢セキュリティも備え、セキュリティカメラ、車載ADAS、AMR等、幅広いエッジAIの進化を加速します。

講評

本製品は、AI処理機能を統合したカメラ用システムオンチップ（SoC）であり、特にドローンなどのモビリティ機器への搭載を想定した設計が特徴である。360度の視界を4方向同時にエッジ側で処理することが可能で、クラウドや外部サーバーへ映像データを転送することなく、デバイス上で分析を完結できる。このアーキテクチャにより、リアルタイム性の向上や通信負荷の低減が実現されている。審査委員会は、本製品をエッジAI技術の実用化を推進する代表的なデバイスとして高く評価した。トレンドを的確に捉え、誰もが手軽にエッジAIの恩恵を受けられる環境を提供している点に価値を見出した。特に、ドローンや監視カメラなど多様な応用分野での需要拡大が期待され、今後の市場展開において重要な役割を果たすと考えられる。



11月19日から東京ビッグサイトで EdgeTech+という国内最大級の組み込みの展示会があり、こちらに Di1 を出展します。それに先駆け EdgeTech+アワード 2025 のエッジテクノロジー優秀賞を受賞しました。おそらく 50 製品くらいの中から選ばれたと理解していますが、この製品の持つ FP4 やステレオビジョン機能といったものが高く評価され、この受賞に至っています。

DMP EdgeAI ソリューションセミナー開催 (9月10日)

「Making the Image Intelligent Together」
 ～最新のエッジAIとイメージセンサーの統合による新たな価値の創出～

- 参加：197名
- 満足度：97.4%
- ソフトバンク、アマゾン他が登壇
- セットメーカー、ソフトウェアベンダー、 商社関係者が多数来場



イベントとして、9月にDMP Edge AI ソリューションセミナーを開催し、約200名のお客さまが参加されました。セットメーカー、ソフトウェアベンダー、商社関係者、業界のいろいろなどから来ていただき、また、ソフトバンク様等に登壇していただくことにより、Di1に対する理解が非常に深まり、高い満足度を得たというフィードバックを得ています。

Di1 GTM戦略 – 成長性の高い市場へのスケーリング



次にDi1のGTM (Go To Market) 戦略です。これは、当然リソースの制約もある中で成長性の高い市場からスケーリングさせていくことをやっています。日本国内のほかに、台湾のパートナーであるiCatch Technology社がこのDi1をV9という製品名で台湾国内および韓国やその他海外市場に向けて販売プロモーションしています。また、成長性の高いという観点でインド市場でのパートナー、チャネル構築を行っています。インドの監視カメラあるいはドローンの成長率が世界で一番高いと予測されており、その要因として

は、例えばインドと中国の地政学的な問題の中でインド国内では中国製のカメラあるいは部品の代替が進んでいる、また同時に国産化を進める動きが今国を挙げて始まっているということが挙げられます。中国製の代替として、日本製の部品が使えることに対して非常に好ましいフィードバックをいただいています。私も8月にインドに行き、向こうでOEM、ODM、あるいはデザインハウス、ディストリビューターと話し、このインド市場の成長、参入のタイミングとしては今が一番いいだろうということ、日本製の部品が使えることに対して非常に歓迎の意を示していただいたことから、この市場に対して高い可能性を感じています。今月から本格的に我々のリソースを投入してこの市場に取り組んでいくことをやっています。それ以外の市場についても順次開拓していきたいと考えています。

「Vision-LLM Insight」提供開始 9月8日



LLM推論エンジンとビジョンAI技術の融合により、従来のシステムでは困難だった「潜在的なリスクの予兆」を高精度で検知し、未然防止に貢献

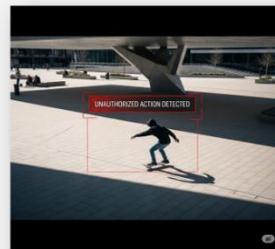
安全

ヒヤリハットの根本原因を「なぜ」のレベルで分析、事故の予兆を捉え、データに基づいた本質的な安全対策と教育を実現



遠隔

膨大な映像から、AIが重要インシデントのみを抽出・要約。管理者は「見るべき点」だけを把握し、迅速な意思決定が可能



お客様の課題解決に特化したオーダーメイドのAIモデルを開発・提供

MAKING THE IMAGE INTELLIGENT

Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

25

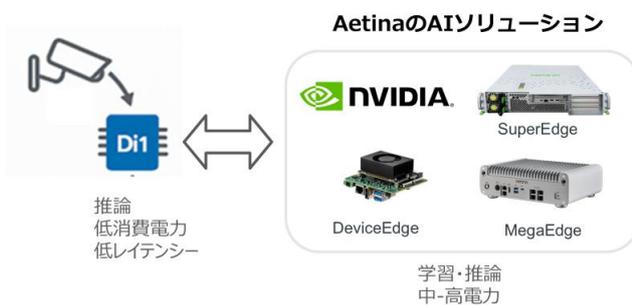
Di1 から離れ、それ以外のトピックスについてお話をします。9月に Vision LLM Insight というセーフティ系の新しいソフトウェアプラットフォームの提供を開始しています。これは生成 AI とビジョン AI の技術を融合することにより、従来のビジョン AI だけの技術では困難だった潜在的なリスクの予兆といったものを検知し、より安全なシステムを構築することができるというものです。例えば当社がデンソーテン様と長年に渡って一緒に取り組んでいる DMS (Driver Monitoring System) や ADAS のような分野においてもこれまでの事象を捉えるだけの AI から、なぜその事象が起きたか、事故の予兆を捉えて、データに基づいた本質的な安全対策が実現できるようになってきています。また、遠隔カメラの膨大なデータの中から重要なイベントのみを抽出してその中で必要な分だけを把握することで、迅速な意思決定が可能になっています。

西尾レントオール様と開発したスケートボーダー検出システムは大阪・咲洲で稼働中、被害防止に貢献しています。AWSの活用により、最新LLMへの迅速なアクセスが可能となり、高精度な認識を早期に実用化できました。



例えば、西尾レントオール様とスケートボーダー検出システムを今年開発し、既に大阪で稼働していますが、この生成 AI とビジョン AI を組み合わせることによって、非常に高い精度で迷惑スケートボーダーの検知が可能になっています。建物の損傷あるいは騒音といった課題に対して、非常に有効な手当になっていると聞いています。

DMPがAetinaが提供するNVIDIA エッジAI製品群を日本市場で販売・サポート
- 「Di1」 + NVIDIAによるハイブリッドコンピューティングを実現 -

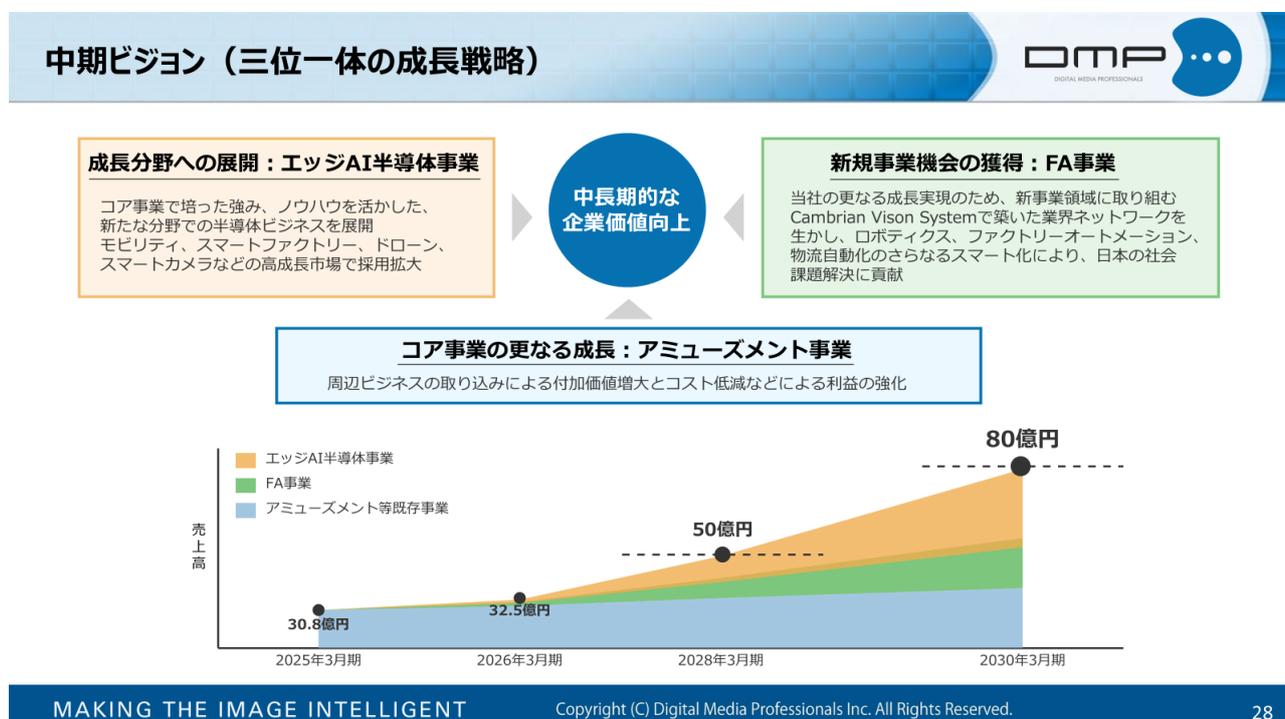


エッジ側で再学習が可能なハイブリッドコンピューティングの例

ユースケース	エッジ		クラウド
	Di1	Aetina (NVIDIA)	
ロボティクス・AMR	障害物検知 360°監視 DMS セキュリティ	経路最適化 SLAM統合 適応学習	大規模 モデル学習 LLM
監視カメラ	VLMによる 異常行動検知 プライバシー	LLMによる 要約・通報 オフピーク学習	

それでは、先ほど少しお話したハイブリッドコンピューティングに関する当社の発表についてお話しします。台湾のAetina社は、NVIDIAのエリートパートナーというNVIDIAの中では一番最高位のパートナーのレベルの会社なのですが、この会社ではNVIDIAのチップを使ったさまざまな製品が作られています。本日の発表は、その製品、特にエッジAIの製品をDMPが日本で販売する販売代理店契約を締結したというものです。これにより先ほどお話したエッジサイドにおける非常に高度なコンピューティング、すなわちエッジサイドにお

ける学習あるいは再学習といったものが可能になってきます。左下の絵で、たとえば Di1 がカメラにつながり多数配置されているような工場の現場の中に NVIDIA の AI の製品を併設することによって推論だけではなく、学習も同時に行われるようになるといった非常に先進的なエッジ AI の環境を我々はターンキーでお客さまに提供することができるようになります。右側にユースケースがあります。監視カメラの例では、工場内などに多数配置されたカメラに Di1 を数十・数百と設置するとともに NVIDIA の AI デバイス数台を置くことにより、Di1 で VLM (Vision Language Model) により、異常行動を検知したり、プライバシーを守ることを行いながら、同じくエッジに設置された NVIDIA のデバイスにおいて生成 AI を使って高度な要約を行うとともに、オフピーク学習 (例えば工場のラインが停止している夜間に現場の環境に合わせ、あるいはその作業に合わせ学習モデルのチューニングをすること) によって、より精度の高い作業、より複雑な作業ができるようになるというようなことが実現できます。DMP の Di1 と NVIDIA のシステムが非常に補完的に協調して動くシステムが構築できることとなります。



当社の中期ビジョンです。三位一体の成長戦略、すなわち一つ目はコア事業であるアミューズメント事業において、さらなる成長、周辺ビジネスの取り込み、コスト低減などにより収益力を強化していきます。二つ目はこのコア事業で培った強み・ノウハウを生かした新たな半導体ビジネスとして今回の Di1 事業を成長分野に展開することで加速していきます。また、今日は時間がなくてお話できなかったのですが、三つ目として FA の外部商材を使った FA 事業を新しい分野・事業として取り組んでいくことにより、3つの事業を三位一体、有機的に関連性を持たせながら成長させることによって当社の中長期的な企業価値を向上させます。数値的な目標としては 2028年3月期に約 50 億円、2030年3月期に 80 億円の売上を目指してまいります。

以上です。どうぞご静聴ありがとうございました。

<お問い合わせ先>

株式会社デジタルメディアプロフェッショナル 経営企画部

TEL:03-6454-0450

URL: <https://www.dmprof.com/jp/ir/>

- 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したものであり、マクロ環境や当社に関連する業界動向等により変動することがあります。従いまして、実際の業績等が、本資料に記載されている将来の見通しに関する記述と異なるリスクや不確実性がありますことをご了承ください。
- 本資料は、弊社をご理解いただくための情報提供を目的としたものであり、弊社が発行する有価証券への投資を勧誘するものではありません。本資料に全面的に依拠した投資等の判断は差し控えます。

[質疑応答]

Q1：売上高の上期進捗率が28%で、営業損失が3億円という状況である。通期予想を据え置いた根拠と下期の回復を見込む理由を教えてください。

A1：中間期におけるアミューズメント分野の弱含みは、パチスロの保通協検定試験適合率が低調であるという一過性の要因によるものです。下期にかけてサミー様など遊技機メーカー各社の有力タイトルの出荷が控えており、現状適合していないタイトルも12月までに適合すると3月発売に間に合うことから、RS1の量産出荷の回復を見込んでいます。

Q2：プロフェッショナルサービス事業が低調である。回復の見込みはあるのか。

A2：安全運転支援向けのプロフェッショナルサービス収益が乏しいことが主な要因ですが、LLM（大規模言語モデル）を活用した案件が進捗中であり、またVision-LLM Insightに関連したより広範なセーフティ分野でのサービスも今後増加すると考えています。また、半導体製造装置向けは継続しますので、それも含めて回復させていきたいと考えています。

Q3：Di1の拡販状況を教えてください。

A3：具体的なお客様とその内容は現段階ではお伝えできませんが、国内外で監視カメラ、ドローン等の具体的な案件が進捗しており、Di1を搭載した評価ボードや開発キットによるお客様の評価が進んでいる状況です。さらに、GTM戦略でご説明した通り、iCatchが製品名V9として台湾等で販売することに加えて、当社として成長ポテンシャルの高いインドでのチャンネル構築を進めていきます。

Q4：Di1は国内外の他社製品に比べて、どこが模倣しにくいのか。

A4：Di1の大きな特徴であるFP4の実装には、当社がGPU開発で長く培ってきた演算器の設計も含めた開発力がフルに活かされており、他社製品は整数演算が多いこともあり、ここは非常にアドバンテージが

あると言えます。また、ステレオビジョンに関しても当社のこれまでの長きにわたる画像処理に対する取り組みが結果として出てくるところであり、一朝一夕で追いつかれることはないと考えています。更には、それと組み合わせて使う iCatch と共同開発した ISP (Image Signal Processor) も他社と比べてかなりの競争力を持っています。そういった個々の技術もさることながら、それを全体的にどういうふうバランスさせていくかというところが、チップの大きな競争力につながっています。今回、電力、性能、コストが非常にいいバランスででき、ローコストでハイパフォーマンス、そしてファンレス、ヒートシンクレスというチップレベルだけではなくシステム全体として組んだときのコストも考えると非常に競争力のある製品になっており、我々の優位性が今後もあると考えます。

Q5：先ほど地政学リスクという話があったが、Di1 の製造はどこで行われているのか。

A5：製造は台湾なので、台湾から供給を受けているという点に限っては、他社半導体製品と同様、地政学リスクは内在していると言えます。

Q6：Di1 の量産時の販売単価と利益率はどの程度になるのか。

A6：現在拡販中の段階であり、また競合もいることからご回答は差し控えます。

Q7：RS1 のシェアはどの程度か。また、以前競合は 4 社程度とのことだったが、現時点ではどうなのか。

A7：ヒットタイトルの時期や規模によって変動するので一概には言えませんが、パチスロでは No. 1 シェアと理解しています。競合については、現在は当社とアクセルの 2 社に絞られてきているのではないかと考えています。

Q8：Di1 に関わる売上は単価×数量という理解でよいか。

A8：基本的には、そのご理解で結構ですが、関連する顧客サポート等の収益も付加されるのではないかと考えます。

以上